

Title (en)

Process for heat-sealing of substrates by utilization of an aqueous polymer dispersion

Title (de)

Verfahren zum Heissiegeln von Substraten unter Verwendung von wässrigen Polymerisatdispersionen

Title (fr)

Procédé de thermoscellage d'une substrate utilisant les dispersions aqueuses de polymère

Publication

**EP 0807672 A2 19971119 (DE)**

Application

**EP 97107811 A 19970513**

Priority

DE 19619465 A 19960514

Abstract (en)

Heat-sealing method involves coating one substrate with an aqueous dispersion of a polymer of olefinically unsaturated monomers having a glass transition temperature (T<sub>g</sub>) < +50 degrees C (heat-sealing adhesive or lacquer) and bonding the coated substrate to a second substrate by pressing at 80-250 degrees C. The novelty is that the heat sealing adhesive is a polymer dispersion to which a water-soluble or water-dispersible starch degradation product is added as protective colloid at the start of or during dispersion polymerisation of the monomers. Also claimed is the use of aqueous dispersions of this type as heat-sealing adhesives or lacquers.

Abstract (de)

In einem Verfahren zum Heißsiegeln von Substraten wie von Kartonagen, Metall- oder Kunststoffolien durch Beschichten eines Substrats mit einer wässrigen Dispersion eines Polymerisats olefinisch ungesättigter Monomere und Verpressen des beschichteten Substrats mit einem zweiten zu verbindenden Substrat unter Erhitzen wird als Heißsiegelklebstoff oder -lack zum Beschichten eine Polymerisatdispersion verwendet, der ein wasserlösliches oder wasserdispersierbares Stärkeabbauprodukt zugesetzt worden ist, und zwar zu Beginn oder während der Dispersionspolymerisation der Monomeren. Das Verfahren eignet sich besonders zur Herstellung von Blisterpackungen.

IPC 1-7

**C09J 5/00**; C09J 157/00; B65B 7/28

IPC 8 full level

**C09J 133/06** (2006.01); C08L 3/00 (2006.01)

CPC (source: EP)

**C09J 133/06** (2013.01); C08L 3/00 (2013.01); C08L 2666/26 (2013.01)

Designated contracting state (EPC)

DE ES FR GB IT SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0807672 A2 19971119**; **EP 0807672 A3 20000322**; DE 19619465 A1 19971120; NO 972200 D0 19970513; NO 972200 L 19971117

DOCDB simple family (application)

**EP 97107811 A 19970513**; DE 19619465 A 19960514; NO 972200 A 19970513